

IHスポットリフロー装置 HJD S+F

半自動 ダブルヘッド仕様

<<電磁誘導 (IH)による非耐熱材料へのダメージレス実装!>>

■特徴

- IH (電磁誘導の原理) で金属部分のみを加熱します。(多段階加熱が可能)
- FPCB接合用、部品接合用 両方のヘッドを装備
- 非耐熱材料上でのはんだ付けを可能にします。PET, PBT, 布, 3D MID 等
ACF 代替 圧を加える必要無し
レーザー代替 はんだ飛散、急激な温度上昇無し
- 省エネ、省スペースを実現 ● 通常のはんだを使用可能
- 3D形状、カーブ面上でのはんだ付けも可能
- はんだ以外の 熱硬化型樹脂 等への適用も可能です。
- 省エネ、省スペース化を実現します。

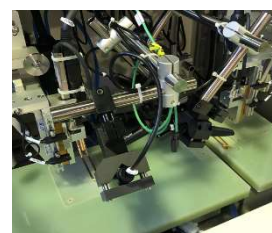


■アプリケーション

- 樹脂製タッチパネル ● RF-ID
- 3D-MID ● ウェアラブル
- LCDバックライト (Soldering LED) ● リワーク



&



FPCB接合用ヘッド

部品接合用ヘッド

■実装例

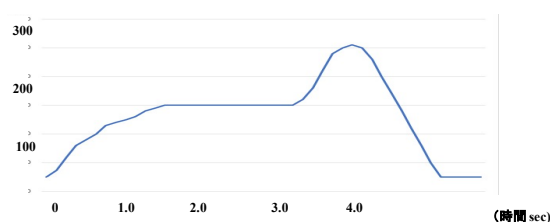
- FPCBの樹脂製タッチパネルとの接合
3D,局面にも対応
- PET,布,紙上でのLED等部品はんだ付け
- 3D MID



本体外形	W800 x D900 x H1500mm
本体重量	600Kg
加熱範囲	W4 x L50mm / W10 x L25mm
誘導加熱電源	2.8kw / 3.5kw
ヘッド仕様	2ヘッド
ワークサイズ (参考)	FPCB :50 x 50mm 電子部品 :1005チップ
加熱可能回路 (参考)	□形状 :Min. □ 0.3x0.3mm 回路幅 :Min. W=0.3mm
加熱方法	10段階式 ステップ加熱

■多段階加熱:ステップキュア 温度プロファイル

(温度℃)



(時間 sec)